

MONTAGE, SCREENING/TESTS

■ Montage

Bauelementespektrum:

Verarbeitung eines breiten Bauelementespektrums,
einschließlich Sonderbauformen

- SMD, BGA
- Nacktchip, Flip-Chip
- Chip and wire, COB

Verarbeitungstechnologien:

- SMD-Bestückung, Reflowlöten
- Vakuumlöten (flussmittelfreies Löten)
- Chipbonden (Kleben, Legieren, Löten)
- Drahtbonden (Ultraschall- oder Thermosonicbonden mit Al- oder Au-Draht, für Leistungsanwendungen Al-Dickdraht bis 500 µm, Au-Band bis 120 µm Breite)
- Impulslöten, Spaltschweißen

Bauelementeschutz/Gehäuse:

- Passivierungsdruck
- Glob-Top
- Tauchumhüllung
- Hermetikgehäuse (Flatpack, Plug-in, Keramik)
- Heat-Sink

Kontaktierung:

- Lötkeim als SIL-, DIL- oder QIL-Bauform für Durchsteck- oder SMT-Montage im Raster 0.5 mm, 0.63 mm, 1.02 mm, 1.27 mm, 2.5 mm, 2.54 mm
- Kundenspezifisch (z.B. Anschlussdrähte, Spezial Lead-frames)

■ Screening und Test

Durchführung gemäß Standardspezifikationen:

- MIL-STD-883
- MIL-PRF-38534
- ESA PSS-01-608/ECSS-Q-60-05
- ESA PSS-01-708
- KTA 1401
- Kundenspezifikationen

Test-Möglichkeiten:

- Burn-in
- Temperatur-/Feuchtelagerung
- Temperaturwechsel
- Vibration
- Beschleunigung
- Prüfung der Grundgrößen U, I, R, L, C, f, t
- Komplexe Funktionsprüfungen entsprechend Kundenspezifikation
- HF-Messungen bis 50 GHz
- Schichtdickenmessung, Materialanalyse mit X-Ray
- Zuverlässigkeitsberechnung